

超高真空搬送ロボット

DTVFR JEL[®]

JEL CORPORATION

特徴 FEATURES

超高真空環境で搬送可能。
超高真空ロボットが、次世代
半導体製造の信頼と効率を革新。
微細化・高純度化に対応する、
最先端の搬送技術をご紹介します。
耐真空度、リークレートは
世界最高水準を誇る機体となります。

- 保持方法: クランプ保持
- 耐真空度: 10^{-7} Pa
- 真空シール:
溶接ベローズ
メタルシール
- 可搬質量:
1.5kg
(チャック、リスト
ブロックを含む)



N₂ パージ対応 EFEM

SSY JEL[®]

JEL CORPORATION

特徴 FEATURES

ウェーハ搬送エリアのN₂濃度を
高める事で、酸素や水分を排除し、
ウェーハの酸化リスクを低減します。
N₂雰囲気エリアを限定することで、
EFEM内全体をN₂パージする
仕様と比較し、N₂消費量を
約1/2に抑制します。

- 保持方法: エッジグリップ
- 通信仕様:
GEM300等対応可
- 対象ウェーハ:
φ300 mm 以外も
カスタマイズ対応可
- 対象PORT数:
2PORT



DTVFR JEL[®]

JEL CORPORATION

Ultra-High Vacuum Transfer Robot

FEATURES

Capable of transfer in an ultra-high vacuum environment.

This ultra-high vacuum robot revolutionizes reliability and efficiency in next-generation semiconductor manufacturing.

Cutting-edge transfer technology, which is designed to meet miniaturization and high-purity requirements.

This robot's vacuum resistance and leak rate boast world class standards.

- **Holding Method:**
Clamp holding
- **Vacuum Resistance:**
10⁻⁷Pa
- **Vacuum Seal:**
Welded bellows, Metal seal
- **Payload Capacity:**
1.5 kg (including end-effector, and wrist block)



SSY JEL[®]

JEL CORPORATION

EFEM with N₂ Purge Capability

FEATURES

By increasing N₂ concentration in the wafer transfer area, oxygen and water vapor concentrations are decreased, reducing the risk of wafer oxidation.

By limiting the N₂ atmosphere area, N₂ consumption is reduced by approximately 50% compared to the specifications that purges the entire EFEM with N₂.

- **Holding Method:**
Edge grip
- **Communication Interface:**
GEM300 compliant
- **Supported Wafer:**
Compatible with various wafer sizes, including $\phi 300$ mm. For details, please ask us.
- **Number of Supported PORTS:**
2 PORTS

